

# 苏州提供半导体设备进口报关检测要求

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：25

细分环节设备均被海外公司寡头垄断1) 光刻机市场规模约160亿美元，3大拥有95%市场。国外EUV光刻机为ASML、尼康、佳能等ASML为已能够实现前道5nm光刻。上海微电子是国内前列的光刻机制造商，公司封装光刻机国内市占率80%，全球40%，光刻机实现90nm制程，并有望延伸至65nm和45nm公司承担多个国家重大科技专项及02专项任务。2) 刻蚀设备市场规模约115亿美金，海外大供应商拥有94%市场份额。在半导体制造中有两种基本的刻蚀工艺：湿法腐蚀和干法刻蚀，目前全球主流刻蚀工艺为干法刻蚀。在湿法刻蚀中，液体化学试剂以化学方式去除硅片表面的材料。湿法腐蚀一般只是用在尺寸较大的情况下（大于3微米）。干法刻蚀是把硅片表面暴露于气态中产生的等离子体，等离子体通过光刻胶中开出的窗口，与硅片发生物理或化学反应，从而去掉暴露的表面材料。刻蚀也可以根据被刻蚀的材料类型来分类，主要分成三种：金属刻蚀、介质刻蚀、和硅刻蚀，其中介质刻蚀和硅刻蚀为主流。目前全球硅基刻蚀主要厂商为Lam(泛林集团)和AMAT(应用材料)，两者拥有97%的市场份额，介质刻蚀主要厂商为TEL(东京电子)和Lam(泛林集团)，拥有97%的市场份额。中微半导体是打入台积电7nm制程的中国设备商。光刻机进口清关公司、刻蚀机进口清关公司、晶圆封装设备进口清关公司。苏州提供半导体设备进口报关检测要求

国内企业的竞争力和机会半导体检测设备的进入门槛较者越强的马太效应突出。半导体检测设备的门槛体现在技术门槛、人才壁垒、资金壁垒和产业协同壁垒。从国内的发展情况来看，近几年半导体设备整体的国产化率不升反降，目前维持在10%左右，较2013年有所下滑，而且国内企业目前的订单主要集中在后道量测领域。华峰测控、长川科技、精测电子目前的客户群主要为中芯国际、士兰微、华虹半导体、长电科技、通富微电、华天科技、华润微电子、日月光、长江存储等国内企业，并没有进入国际前列半导体企业的供货商名单。进入2020年，半导体前道量测设备国产化有零星出货，国产半导体量测设备主要参与者为精测电子和上海睿励。精测电子在半导体检测设备领域布局为完整。国内目前实现半导体检测设备产业化的公司主要有精测电子、长川科技、华峰测控和上海睿励。但从业务布局来看，精测电子是国内同时布局前道量测设备和后道测试设备的企业，目前在已上市的前道量测设备公司里边，精测电子也是一家。据了解，精测电子在半导体测试领域的布局已基本完成，与韩国IT&T合资设立的武汉精鸿电子技术有限公司主要聚焦自动检测设备ATE领域（主要产品是存储芯片测试设备）。青岛靠谱的半导体设备进口报关诚信推荐二手半导体设备清关要求、进口旧半导体设备CCIC代理、上海专业半导体设备清关公司。

硅下游之一:集成电路产业链集成电路设备与材料为集成电路产业链支撑产业。设备端看，芯片制造与封测各环节均需要用使用大量半导体设备，包括晶圆制造设备、封装设备、测试设备、其他

前端设备等，其中，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备价值占比居前。半导体制造产业包括集成电路、分立器件、光电子器件、传感器四大类，其中，集成电路为半导体产业。根据全球半导体贸易统计组织的统计数据，2018年集成电路占总销售额比例为，半导体分立器件、光电子器件、传感器分别为、、。集成电路下游应用涉及PC通信、医疗、物联网、信息安全、消费电子、新能源、汽车等多产业。根据ICInsights数据，2018年全球市场下游构成主要为计算机、通讯、消费电子、汽车电子等，占比分别为、、，通讯将超越计算机成为集成电路大应用领域，占比约为。4、硅下游之二：太阳能光伏产业链光伏为多晶硅又一重要的应用行业。晶体硅太阳能光伏产业链由上游多晶硅原料采集加工；中游电池/电池组件制造；下游光伏电站系统集成运营构成。其中，上游涉及晶体硅原材料、硅棒、铸锭、硅片等；中游涉及电池片、封装EVA胶膜、玻璃、背板、接线盒等。降本增效为光伏行业贯穿始终的追求目标。

作为半导体产业的发动机，半导体设备是半导体技术迭代的基石。大型制造业的发展都需要其产业设备的发展推动，半导体产业也是如此。踏着晶体管集成度约18个月翻番的摩尔定律旋律。半导体工艺从上世纪70-80年代的3-10微米，发展至目前的7nm制程，设备的进步起着至关重要的基石作用。集成电路制造工艺复杂，所需设备种类，设备精密度要求高。集成电路的制作是将在EDA软件上设计好电路图制作成掩模(Mask)然后通过众多复杂的工艺，像搭积木一般，一层一层构建在硅晶圆之上，形成裸芯片，然后进行封装测试，成为成品。整个制造流程大约涉及到300-400道工序，半导体材料、设备和洁净工程等上游产业链作为重要支撑。2000年以来全球设备市场发展趋势回顾：工艺制程世代升级催化新一代半导体制程设备，投资规模逐级提升先进制程对设备需求显现日益加速增长。半导体技术制程随着摩尔定律的节奏而进步，每更新一代工艺制程，则需更新一代更为先进的制程设备。申请报告（报告详细写明企业的基本情况、生产情况、进口机电设备的用途、制造日期、使用年限、现在状况。

据SEMI的统计数据，目前全球半导体检测类设备市场规模超800亿，其中前道量测设备市场规模406亿元左右，后道测试设备399亿元左右。随着5G及其物联网技术的发展，各大存储器厂商加大对3DNAND堆叠技术的投入，继续资本开支增长。从全球范围内来看，半导体检测设备呈现寡头垄断格局。在前道检测设备领域中，科磊、应用材料、日立合计占据了76%的市场。后道测试主要分为测试机、探针台、分选机三大组成部分。后道测试机头部企业主要是泰瑞达和爱德万，二者市占率分别约为50%和40%；中芯片测试机几乎被国外企业垄断，国内华峰测控和长川科技在部分细分领域也有所突破，北京冠中集创深耕CIS芯片测试机，开始向Memory领域渗透。后道探针台主要是东京电子、东京精密，二者市占率合计超过80%；国内企业中长川科技处于研发阶段，深圳矽电处于测试阶段。后道分选机主要是爱德万、科休&爱普生等，合计市占率合计约60%，国内参与的企业主要有长川科技等。台积电测试设备的供应商主要来自于国外企业，国内供应商比例较低。随着先进制程的线宽越来越细，避免光刻胶产生晶圆报废事件再次发生给公司带来利润损失，台积电专门成立了200人规模的品质管理检测单位。万亨供应链有成功操作完成4代/6代半导体设备（旧）整线的设备进口。海口实力的半导体设备进口报关公司

半导体生产线设备进口清关物流公司，半导体进口清关物流公司。苏州提供半导体设备进口报关检测要求

半导体设备位于整个半导体产业链的上游，在新建晶圆厂中半导体设备支出的占比普遍达到80%。一条晶圆制造新建产线的资本支出占比如下：厂房20%、晶圆制造设备65%、组装封装设备5%，测试设备7%，其他3%。其中晶圆制造设备在半导体设备中占比比较大，进一步细分晶圆制造设备类型，光刻机占比30%，刻蚀20%□PVD15%□CVD10%□量测10%，离子注入5%，抛光5%，扩散5%。17年全球半导体设备市场总量约为566亿美元，同比+37%，2018年预计在600亿美元规模。中国是全球半导体设备的第三大市场，17年中国半导体设备，增速27%。1956年制定的《1956-1967科学技术发展远景规划》中，已将半导体技术列为四大科研重点之一，明确提出“在12年内可以制备和改进各种半导体器材、器件”的目标。同期教育部集中各方资源在北京大学设立半导体专业，培养了包括王阳元院士、许居衍院士等批半导体人才。半导体产业链复杂、技术难度高、需要资金巨大，且当时国内外特定的社会环境，中国在资金、人才及体制等各方面困难较多，导致中国半导体的发展举步维艰。（图表1、2为半导体产业链图）直到70年代，中国半导体产业的小规模生产才正式启动。原电子工业部部长在其著作《芯路历程》中回忆这一阶段历史。苏州提供半导体设备进口报关检测要求

万享进贸通供应链（上海）有限公司弘扬“专注-专业”精神在行业内首先提出“专注于进口”创新理念，以客户需求为导向。打破行业的习俗和假设，探索出新的服务、新的商业模式。把原本由管理咨询公司、第三方物流公司、外贸进出口公司、报检报关公司、清关公司、仓库管理公司等分别履行的多种职能有机地结合在一起，把智慧和资源凝聚到“全球进口门”服务上，大限度地优化进口物流供应链方案，服务贯穿整个国际贸易流程：一般贸易代理、国际贸易结算、进口单证办理、进口物流配送、进口清关、食品仓储。万享供应链用人才整合资源，为客户创造价值。为企业提供专业的“国际供应链管理外包”服务，立志成为中国\*\*的全球进口供应链管理服务品牌。构建了以物流、商流、资金流、信息流四流合一为载体，以全球采购中心和产品整合供应链服务为\*\*的全球整合型供应链服务平台。万享在上海-大连-北京-青岛-天津-苏州-宁波-武汉-广州-深圳\*\*国内沿海有分公司，全国港口/机场都可以代理通关。